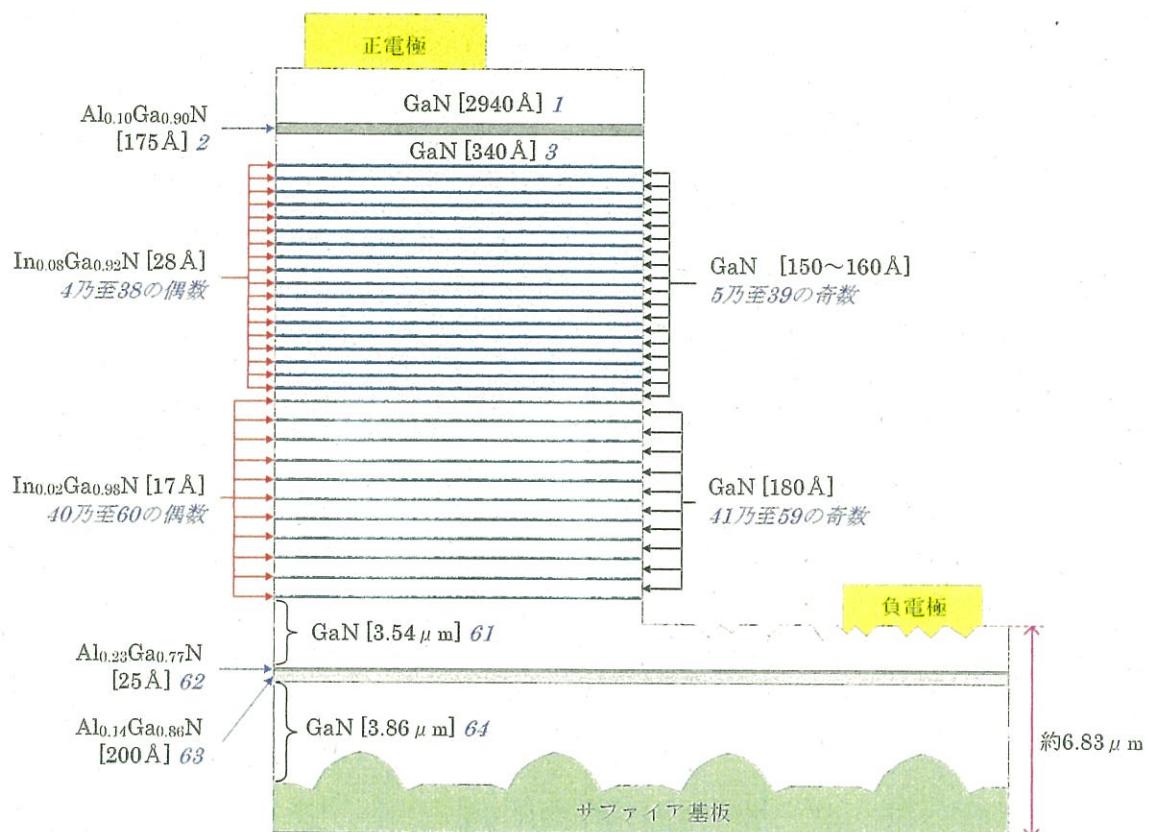


(別紙9)

## 被告製品構造説明書(2)

被告製品の半導体の積層構造1～64は以下のとおりであり、その模式図を下の積層構造模式図に示す。なお、積層構造模式図では各層に正電極側から順に番号が振られており、以下、各番号を用いて各層の機能等を説明する。



被告製品の積層構造模式図

各層の組成と膜厚は次のとおりである。

層番号		基本組成	混晶比	膜厚(Å)
層(1)		GaN		2940
層(2)		AlGaN	Al 10%	175
層(3)		GaN		340
層(4)	偶数層 ～(39) 奇数層	InGaN	In 8%	28
層(40)		GaN		150～160
層(41)	偶数層 ～(60) 奇数層	InGaN	In 2%	17
層(61)		GaN		180
層(62)		AlGaN	Al 23%	35400
層(63)		AlGaN	Al 14%	25
層(64)		GaN		200
				38600

被告製品の構造は次のとおりである。

- ① 層(1)及び層(2)はp型窒化物半導体層である。
  - i) 層(1)は窒化物半導体(GaN)からなる厚さ2940Åのp型窒化物半導体層である。
  - ii) 層(2)は②の活性層よりもバンドギャップエネルギーの大きなAlを含む窒化物半導体(AlGaN)からなる厚さ175Åのp型窒化物半導体層である。
- ② 層(3)ないし(39)の各層は量子井戸構造の活性層を形成している。
  - i) 層(3)は窒化物半導体(GaN)からなる厚さ340Åの障壁層である。
  - ii) 層(4)、(6)、(8)、(10)、(12)、(14)、(16)、(18)、(20)、(22)、(24)、(26)、(28)、(30)、(32)、(34)、(36)、(38)の各層はInを含む窒化物半導体(InGaN)からなる厚さ28Åの井戸層である。
  - iii) 層(5)、(7)、(9)、(11)、(13)、(15)、(17)、(19)、(21)、(23)、(25)、(27)、(29)、(31)、(33)、(35)、(37)、(39)の各層は窒化物半導体(GaN)からなる厚さ150~160Åの障壁層である。
- ③ 層(40)ないし(61)の各層はn型窒化物半導体層である。

以上